



Ampoc Far East Co., Ltd

揚博科技股份有限公司  
Ampoc Far-East Co., Ltd.

股票代號：2493



2018/05/23



- 一、公司簡介
- 二、公司沿革
- 三、產業應用與產品介紹
- 四、財務資訊
- 五、未來展望





# 一、公司簡介

公司名稱	揚博科技股份有限公司
地址	台北市松德路171號17樓
電話	(02)2726-2220
董事長兼總經理	蘇勝義 先生
資本額	新台幣 114,437 萬元
設立日期	1980年11月1日
員工人數	280人
公司網站	<a href="http://www.ampoc.com.tw">www.ampoc.com.tw</a>



董事長兼總經理  
蘇勝義先生



## 二、公司沿革

### AMPOC's History



2006/12

• 吸收合併百分之百持有之揚鑫投資股份有限公司，合併後資本額不變

2002/01

• 經證管會核准於 2002/1/23 股票掛牌上市，代號 2493。

2001/06

• 申請公司名稱變更為「揚博科技股份有限公司」，盈餘轉增資，股本增加為 90,500 萬元。

2000/10

• 辦理現金增資 4,800 萬元、盈餘轉增資 3,997 萬元、合併資本公積轉增資 7,424 萬元、員工紅利轉增資 401 萬元，增資後資本額為新台幣 73,729 萬元。

1999/12

• 合併台北化工機械股份有限公司，並增資發行新股 21,107 仟股，股本增為 57,107 萬元。

1998/12

• 獲准成為公開發行公司，辦理盈餘轉增資 10,200 萬元，增資後資本額為新台幣 30,000 萬元。

1998/03

• 設立精密儀器檢測服務實驗室，加強對客戶服務內容與品質。

1997/03

• 購置並遷入台北市松德路 171 號 17 樓之新辦公室。

1987/05

• 日本 TCM 於中壢工業區設立台北化工機械股份有限公司，產製 PCB 濕製程設備，本公司除參與投資外並取得日本以外全球獨家銷售權。

1980/11

• 揚博企業股份有限公司成立，股本 100 萬元。



## 三、產業應用與產品介紹

### □ 產業應用

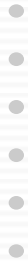
- 半導體前段
- 先進封裝製程
- MEMS

### □ 產品介紹

- 垂直Ampoc Wing Etching系統
- 傳統水平式設備
- 慣性元件應用產品檢測設備



Ampoc Far East Co., Ltd



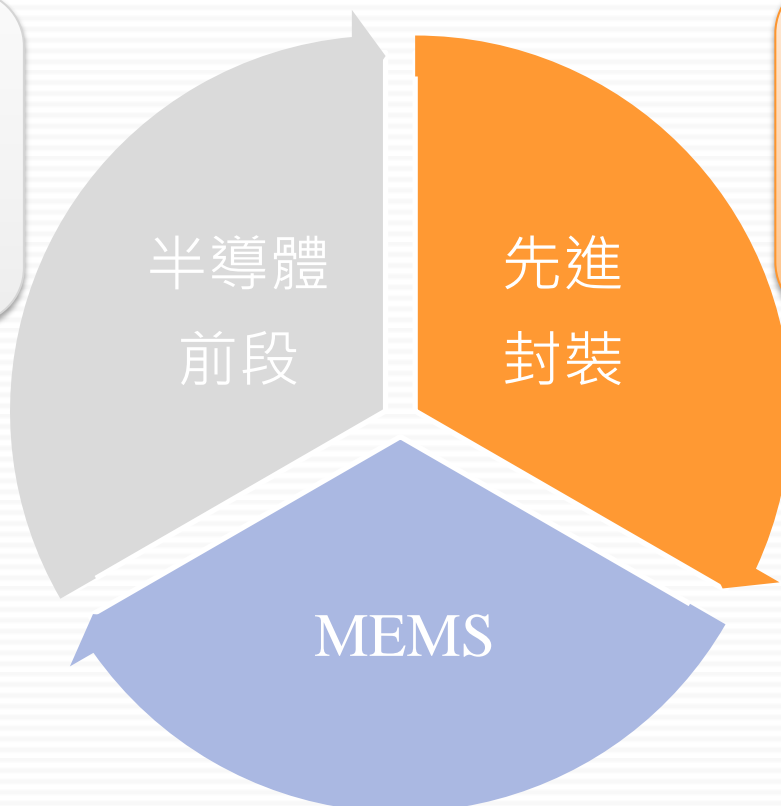
## 產業應用





# 產業應用-核心發展策略

- ✓ 覆晶晶圓凸塊封裝電鍍液
- ✓ 3D-IC · FOWLP 高速電鍍藥水
- ✓ 晶圓凸塊UBM層高選擇性蝕刻液
- ✓ 高解析光阻液
- ✓ Hard Mask



- ✓ 導線架 metal finish 用藥水
- ✓ QFN導線架 電著光阻
- ✓ 高階fine pitch探針卡用MLO

- ✓ MEMS WLO測試設備
- ✓ IMU應用裝置測試設備
- ✓ 壓力感測器測試設備



# 主要客戶群與合作夥伴



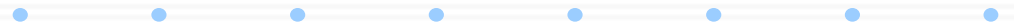


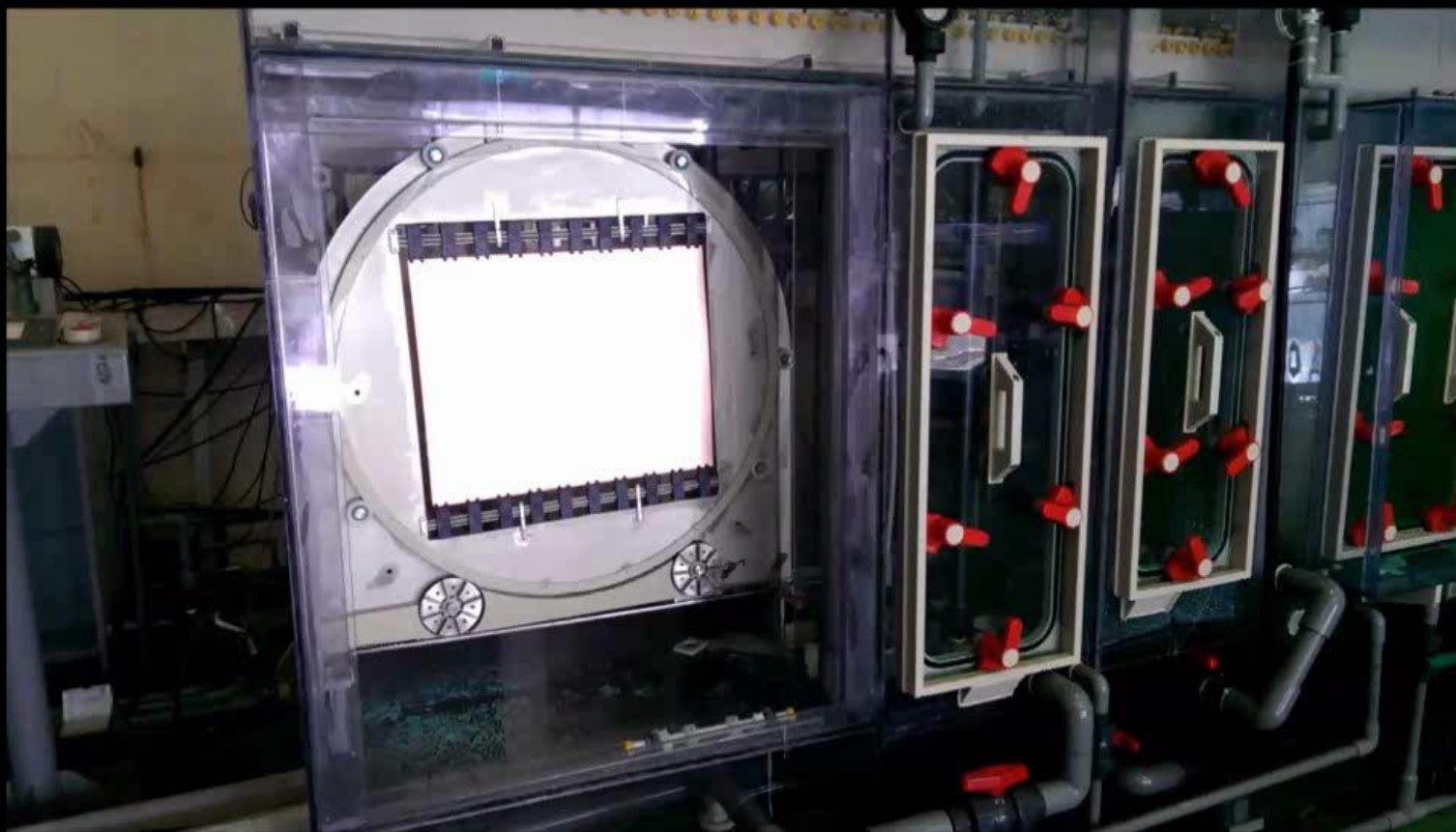


Ampoc Far East Co., Ltd



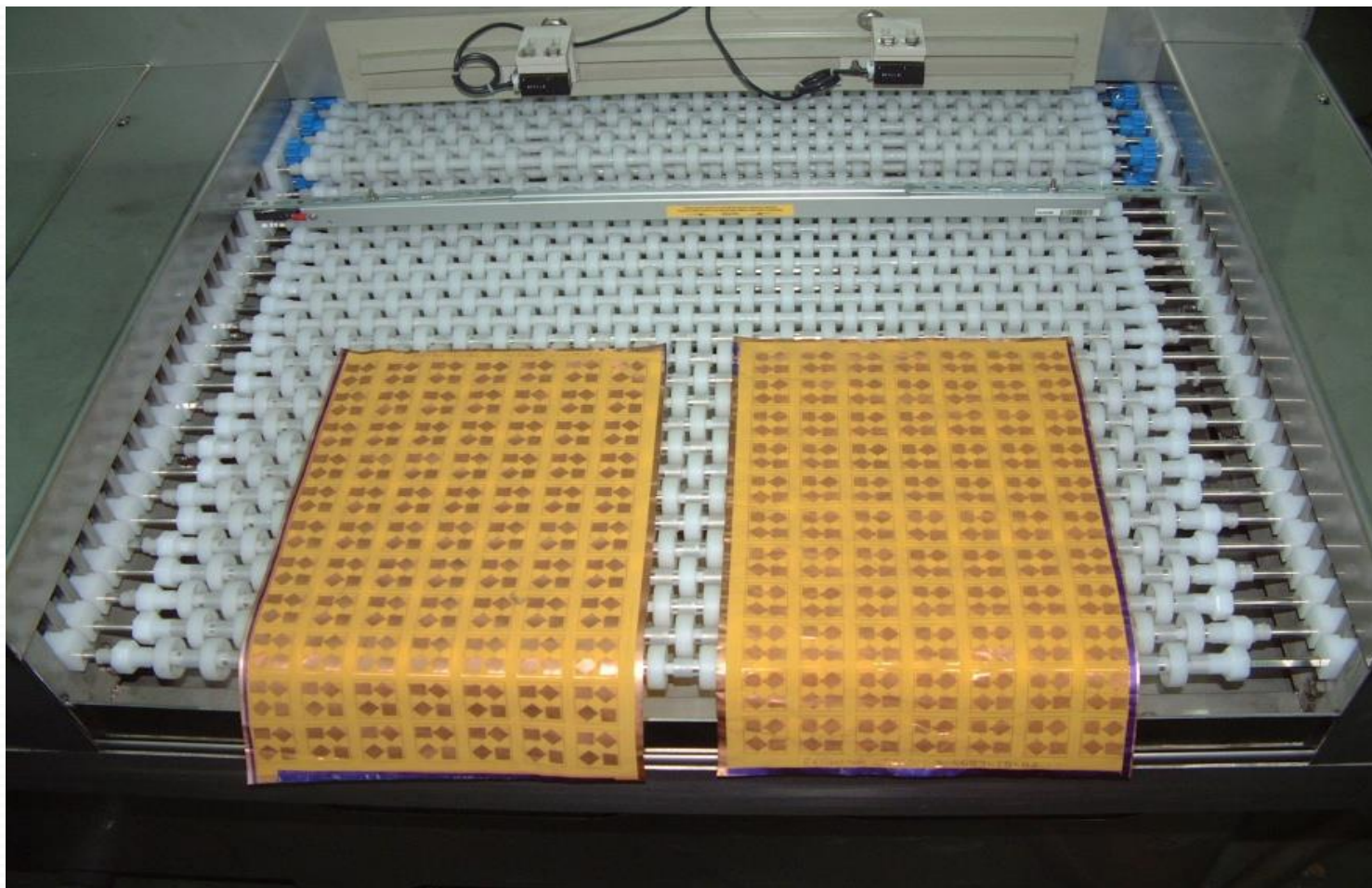
# 產品介紹







傳統水平式設備：板面接觸滾輪造成刮傷與汙染問題





Ampoc Far East Co., Ltd

# METIS-慣性元件應用產品檢測設備

00:00:08:19

# AFORE

Meant for MEMS

# AFORE

Meant for MEMS

# AFORE





## 2018年市場狀況與未來展望

2018年在全球政經局勢詭譎多變的情勢下，今年將會是全球電子產業的拐點，相較既有的成熟技術，下半年在人工智慧與5G高速通訊的應用發展將會有突破性的進展。

台灣在多年的電子業經驗下，保有硬體上的優勢及完整的上下游供應鏈，揚博代理部份秉持著多年於電子業界的經營理念，仍以審慎的態度持續耕耘，進而積極佈局半導體前段、先進封裝、智能感測元件(MEMS)此三大方向。



## 台灣PCB產業2017年回顧及2018年展望

- 2017年全球電路板產值達到美金650億，達到近十年來的最高水準。
- 2017年主要PCB生產國市佔率分別為：
  - 台灣:31.3% ↑ (30.2%)
  - 日本:20.5% ↓ (21.6%)
  - 韓國:14.3% ↓ (17.6%)
  - 中國:17.4% ↑ (16.8%)
- 台灣以三成以上市占居首位，日、韓各有不同因素衰退，中國則處於強勁成長。
- 2017年通訊與汽車電子仍扮演PCB產業主要成長動能。
- 2018年預估PCB擴充產能其產品包含HDI、軟板、軟硬接合板、應用市場包含智慧型手機、汽車電子、物聯網、網通等市場。
- 2018年設備需求觀察重點：
  - 一、智慧型手機規格更改對HDI、類載板及軟板製程設備需求。
  - 二、陸資廠商正式跨入中、高階產品競爭，包括HDI、軟板、類載板設備需求。
  - 三、汽車電子廣泛運用後對相關設備需求。



## 四、財務資訊

### 最近三年度綜合損益表

單位：新台幣仟元

項目	年度	104年	105年	106年
營業收入		2,200,585	2,312,375	2,281,684
營業毛利		617,928	749,415	677,644
毛利率(%)		28.08	32.41	29.70
營業利益		305,660	390,622	310,926
稅後淨利		286,899	326,235	247,036
每股盈餘(元)		2.51	2.85	2.16



## 最近三年度資產負債表

單位：新台幣仟元

項目	年度	104年	105年	106年
流動資產		2,370,950	2,310,668	2,493,281
非流動資產		657,258	685,653	752,903
資產總額		3,028,208	2,996,321	3,246,184
流動負債		748,692	657,291	860,792
非流動負債		98,100	111,804	130,608
負債總額		846,792	769,095	991,400





## 最近三年度財務分析

項目	年度	104年	105年	106年
負債佔資產比 (%)		27.96	25.67	30.54
流動比率(%)		316.68	351.54	289.65
存貨周轉率(次)		2.15	2.37	2.09
權益報酬率(%)		13.07	14.80	11.02



## 五、未來展望

(一)業務發展方向

(二)競爭優勢

(三)發展不利因素及對策





## (一) 業務發展方向

➤ 研發創新技術因應未來趨勢之利基設備：

1. HDI及類載板製程設備；

2. 軟板及厚板製程設備；

3. 車載板製程設備；

4. 智慧化設備。

➤ 開發未來新市場客戶：

1. 東南亞；

2. 印度。



## (二) 競爭優勢





## (三)發展不利因素及因應對策

### ➤同業低價競爭

投入大量的研發人力及經費，持續研發各項創新技術之設備，爭取製造高階產品客戶的製程設備之利基型訂單。

### ➤人力及材料成本提高

透過基礎實驗參數設計新型結構及開發適用新材料，降低高價材料使用。



*Thank you*  
*The End*

